

【お知らせ】

2024年10月7日  
株式会社日立ソリューションズ

## シリコンバレー発、社内起業で設立したスタートアップ Paletter 社が、 国内最大規模のアカデミア横断型起業支援プログラム「1stRound」の支援先に採択

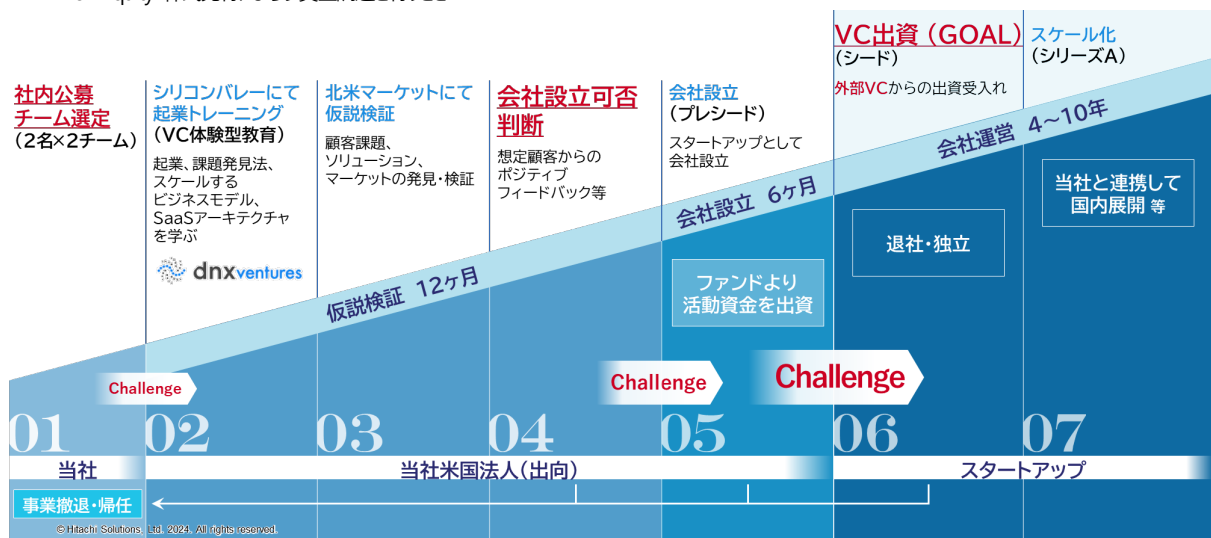
株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：山本 二雄／以下、日立ソリューションズ）は、社員がシリコンバレーで起業に挑戦できる「スタートアップ創出制度」を2023年4月から本格運用しています。本制度を利用し、2023年11月に設立したPaletter, Inc.（本社：米国カリフォルニア州、CEO：井上 正彦、以下 Paletter）が、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（本社：東京都文京区本郷、代表取締役社長 植田浩輔、以下、東大IPC）が運営する起業支援プログラム「1stRound」の第11回支援先として採択されました。

「1stRound」は、国内最大規模のアカデミア機関が共催するプログラムで、毎年2回各回約8件が採択されます。採択されたスタートアップには、Non-Equity\*1資金やクラウドリソース、オフィスなどの開発環境およびキャピタリストと専門家による6ヶ月のハンズオンが無償提供されます。

Paletterは、採用面談をAIで支援するサービスを開発し、米国の大手ファーストフードチェーン（ニューヨーク店舗）で利用されています。2024年4月には、マイクロソフト社のスタートアップ向けプログラム「Microsoft for Startups Founders Hub」において最上位の「Scale」に選出され、15万ドル分のMicrosoft Azureの利用権を獲得しました。Paletterは、このたびの「1stRound」による後押しを受け、一層の事業拡大に向けて成長を加速してまいります。

日立ソリューションズは今後も、社会課題解決につながるサービスを生み出すスタートアップの創出をめざし、社会のサステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）の実現に貢献していきます。

\*1：Non-Equity 株式発行によらず資金調達を行うこと



図：日立ソリューションズの「スタートアップ創出制度」概要

## ■ 会社の概要

会社名：Paletter, Inc.

事業内容：採用担当者の好みを学習したAI Poweredソフトスキルアセスメントツールの提供

役員：CEO 井上 正彦

設立：2023年11月9日

URL：<https://www.paletter.co/>

## ■ Paletter, Inc. CEO 井上 正彦のコメント

「Paletterは、採用担当者本人と同じ評価基準を持つ分身AIによるスクリーニングサービスを提供しています。従来のスクリーニング時における評価と採用面談での『イメージのズレ』を減らし、面談回数を削減するというアプローチや、米国市場を見据えたグローバルなサービスである点を、『1stRound』に評価いただきました。顧客目線での価値や技術の伝え方、ビジネスの差別化ポイントの明確化など、的確かつ実践的なアドバイスをいただき、日々事業が前進していると感じています。弊社は今後も、日本人による米国発スタートアップとして、人とAIが寄り添い、ともに成長する希望ある未来づくりをめざして取り組んでいきます。」

## ■ スタートアップ創出制度について

URL：[https://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/news/2023/0324\\_2.html](https://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/news/2023/0324_2.html)

## ■ 会社設立フェーズ突破のお知らせ（2024/2/1）

URL：<https://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/news/2024/0201.pdf>

## ■ 起業支援プログラム「1stRound」について

URL：<https://www.1stround.jp/>

東大 IPC からの発表はこちら（URL：[https://www.utokyo-ipc.co.jp/news/2024/10/1stround\\_11th/](https://www.utokyo-ipc.co.jp/news/2024/10/1stround_11th/)）  
をご覧ください。

## ■ 報道機関お問い合わせ先

株式会社日立ソリューションズ 経営戦略統括本部 経営企画本部 広報部 [担当：秋山、大鳥]

〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-7

E-mail：[koho@hitachi-solutions.com](mailto:koho@hitachi-solutions.com)

※ その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---